赛雅浆料
SRYEO PASTE
深圳市赛雅电子浆料有限公司
Shenzhen Sryeo Electronic Paste Co., Ltd.
www.sryeo.com sales@sryeo.com

产品规格书/Specification

产品/product:	银钯浆料/ Ag/Pd paste
料号/Part number:	02H-1803

适用范围/Application:

此产品适用于厚膜电路、片式电阻电极使用
Suitable for chip resistor、thick film circuit electrode.

使用条件/Operating conditions:

基材 Substrate	氧化铝陶瓷 Alumina ceramic
印刷 Printing	200-300 目丝网印刷 200-300 mesh stainless screen
流平 Levelling	5-15min minutes at room temperature 室温下流平 5-15 分钟（时间根据流平的实际情况决定）。
干燥&烧结 Drying &Sintering	通风烘箱烘烤 100-150℃，10-15 分钟 100-150℃ 10-15 min 隧道炉空气气氛下烧结，峰值 850℃（推荐值），10 分钟。 Atmospheric firing in belt furnace with peak time of 10 mins at 850℃
Thinner	ST-1000

性能/Characteristics:

1. 浆料性能/Paste Characteristics:

	性能 Characteristic	标准 Standard	测试方法及条件 Test method and conditions
1	Fineness	≤5µm	FOG test
2	Viscosity	130-380Pa.s	Brookfield HBT utility cup and spindle (SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃, Brookfield HBT（博利飞）粘度计， 转子 SC4-14/6R), 10rpm, 25±1℃ 粘度可根据用户实际需要调节。

2. 烧结后特性/Characteristics after firing:

在 1 烧结条件下，膜厚 8-12µm Check fired film produced under the conditions specified in 1）, (Film thickness is 8-12µm.)

特性 Characteristics	Standard 标准	测试方法和条件 Test method and conditions

www.sryeo.com sales@sryeo.com

3	Resistivity 方阻	≤8mΩ/□	Test pattern 0.6mm×60mm 测试图形 0.6mm×60mm
4	Adhesion strength 附着力		Peel Test: 0.5mmφ Tin plated Cu wire soldered on 2mm×2mm Pad. 0.5mmφ锡浸铜线，焊接面积 2mm×2mm Solder: 96.5Sn/0.5Cu Mildly activated flux used. 焊料：96.5Sn/0.5Cu
	Initial 初始附着力	≥46.5N	

保存条件，有效期/Storage condition and Term of validity

产品应在 5-25℃的环境温度下密封储存，有效期为产品发货之日起 1 年。

The product shall be guaranteed for 1 year after shipping date, keep tightly under at 5-25℃

包装方式/Packaging method：

标准包装，1000g/罐, 样品可提供 200 克小罐包装

Standard package 1000g/can，if you need sample to test, available 200g with small package.